

2024年3月期 決算説明会 質疑応答集

- Q 24年3月期第4四半期の受注について、地域別とアプリケーション別で中身を教えてください。
- A 24年3月期第4四半期の装置の受注高をアプリケーション別にみると、DRAM向けが約45%、Logic/Foundry向けが31%、NAND向けが25%でした。地域別では、中国向け、韓国向けが大きくなりました。
- Q 今後の受注の見通しを教えてください。
- A 25年3月期の装置ビジネスの売上収益が24年3月期と比較して26%伸びる計画のため、受注高も同程度伸びていくと考えています。足元の状況としては、25年3月期第1四半期にLogic/Foundry向けとDRAM向けの大型受注が入ってくる想定です。NAND向けの新たな投資は25年3月期終盤に戻ってくるかどうかと見ています。
- Q 24年3月期第4四半期の売上総利益率が第3四半期と比べて低下した要因を教えてください。また、25年3月期の売上総利益率の見通しを教えてください。
- A 24年3月期第4四半期はサービスの売上の一部が25年3月期第1四半期にシフトし、第3四半期に比べて収益性の高いサービス売上が減少したことと製品ミックスが変化したことが要因です。25年3月期の売上総利益率は、先端デバイス向けの高付加価値装置の売上が増加することから、24年3月期より改善する想定です。
- Q 25年3月期の業績予想の調整後営業利益の増減要因について、研究開発費が増える一方で販売費・一般管理費がそれほど増えていませんが、販売費・一般管理費を抑制することはできるものなのでしょうか？
- A 売上が増えていく中で販売費・一般管理費も増えていきますが、人件費や償却費などを含む研究開発費以外の販売費・一般管理費は大きく増えるものではありません。
- (補足)当社では、23年3月期に、今後の成長を見据えて人員増強をはじめとする運営基盤の強化をはかり、23年3月期の販売費・一般管理費は22年3月期に比べて80億円増加しています。その効果により、今後の販売費・一般管理費の上昇は緩やかになると考えています。
- Q 25年3月期の業績予想について、アップサイド、ダウンサイドを考える上でオポチュニティもしくはリスクを教えてください。
- A 25年3月期は、特に下期において、地域別では中国向け、アプリケーション別ではDRAM向けの売上見通しを慎重に見積もっています。中国での投資が24年3月期に引き続いて維持される、あるいは、DRAMに対する投資が当社の想定を上回る場合は業績の上振れ要因となります。足元の受注状況を見る限り、中国での投資に減速感はありませんが、昨今の国際情勢をふまえて中国に過度な期待をしないという主旨です。
- Q Logic GAA(Gate All Around)のPOR獲得の状況を教えてください。
- A 当社にとって重要なLogic GAAの工程のうち3分の2について開発PORを獲得できている状況です。受注済みと受注見込みを合わせて100億円で手が届く規模と申し上げてきましたが、25年3月期の売上収益として100億円を超える規模になる見込みです。

Q Logic GAA での POR 獲得は、開発向けと量産向けのどちらでしょうか？

A 現時点では開発向け POR です。量産 POR を獲得できればより大きな売上になると期待しており、量産 POR 獲得に向けて取り組んでいるところです。

Q Logic の FinFET (Fin Field-Effect Transistor) から GAA、GAA から CFET (Complimentary Field Effect Transistor) への移行で想定している成長の度合いを教えてください。

A FinFET から GAA への移行で当社にとって重要な工程が 1.2 倍になり、FinFET から CFET への移行で 1.4 倍になると想定しています。GAA では、第 1 世代よりも第 2 世代で工程が大きく増加すると見えています。

Q 25 年 3 月期業績予想の中で、中国の DRAM 向けはどれぐらいの構成比でしょうか？米国による中国への輸出規制強化のリスクはないのでしょうか？

A 詳細な構成比の回答は控えますが、中国での DRAM に対する大きな投資は継続されると見えています。輸出規制強化に関しては、現時点で当社ビジネスへの影響に変化はないと見えています。

Q 中国向け以外の HBM 向けなど DRAM の見通しを教えてください。

A 当社は HBM の製造工程と直接リンクしたビジネスを持っているわけではありませんが、先端 DRAM で POR を獲得できていますので、今後 HBM 向けを含めて先端 DRAM の需要が拡大することによって、市況が活発化し、当社のビジネスを伸ばしていけると認識しています。

Q NAND はレイヤー数の増加により微細化効果が得られてしまうこともあり、グリーンフィールド投資からマイグレーション投資に移行する動きが見られているのではないかと考えています。マイグレーション投資主体になっても、NAND 投資におけるバッチ ALD の優位性は維持もしくは拡大できるのでしょうか？

A NAND のレイヤー数が増えると成膜の難易度が上がることから、従来にはなかった要件が生じ、当社のバッチ ALD に対する需要が拡大すると考えています。その意味で、マイグレーション投資であっても、装置の置き換えやアップグレードで一定の投資を引き込むことはできると考えています。

Q 直近の市場データを参照するとバッチ成膜装置のシェアが低下しているようだが？

A バッチ CVD 装置市場は堅調に推移する一方で、バッチ ALD 装置市場は先端デバイス向けの投資抑制により縮小しています。当社はバッチ ALD 装置市場で高シェアを維持していますが、バッチ CVD とバッチ ALD を合わせたバッチ成膜装置市場で見るとシェアが低下したものと自覚しています。LP-CVD や酸化アニールの分野では伸びしろがあると考えており、シェア拡大に向けた取り組みを強化しているところです。

Q 競合製品との比較でバッチ ALD 装置の競争優位性を教えてください。

A 当社のバッチ ALD 装置(バッチ ALD 対応成膜装置)は、ラージバッチ成膜装置とミニバッチ成膜装置があり、ミニバッチ成膜装置はより難易度の高い成膜が可能な装置で、当社のみが供給している装置ですので、競争優位性には変わりはないと考えています。

Q SiC パワーデバイス向け装置による増収が見込まれる中、サービスビジネスの 25 年 3 月期見通しは保守的に思えるのですが、考え方を教えてください。

A サービスビジネスは、200mm 以下の装置の販売、装置の・移設改造、保守メンテナンス、部品販売などで構成されていますが、25 年 3 月期は部品販売が前期比で減少する見込みです。これは、前期に中国で成熟ノードの新工場が稼働する際の特需的な要素があったためです。

Q WFE(Wafer Fab Equipment)が1,100~1,200億ドルとなる場合、売上収益3,000~3,300億円で売上総利益率43%以上となる中期目標を開示していますが、現状の見通しを教えてください。

A 売上収益が3,000億円を超えるタイミングはまだ言及できる状況にありませんが、27年3月期以降に射程圏内に入ってくるのではないかと考えています。今年度後半から来年度にかけて、市場がどのような動きをしていくかを慎重に見ていきます。売上総利益率43%というターゲットについては、25年3月期に近いところまでいく想定をしています。26年3月期、27年3月期には収益性の高い新製品の売上が増加する見込みで、43%以上をめざしていけると考えています。

Q 受注から売上までのリードタイムはどのくらいですか？

A 現在のところ6カ月程度です。一時期、入手困難な部品がありリードタイムが長くなっていましたが、現在は平常化しています。

Q リードタイムを考慮すると、25年3月期下期の売上については、上期の受注状況によって動く可能性があるということでしょうか？

A はい。25年3月期下期の売上計画は堅めに策定していますが、今後の受注動向を注視していきます。